

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 10 日。

预计会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市大兴区天荣街 9 号世农大厦 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与徐州金龙湖供应链管理有限公司开展供应链业务合作暨对外担保的议案》

为满足公司生产经营需要，公司及全资子公司江苏天科合达半导体有限公司计划与徐州金龙湖供应链管理有限公司开展供应链业务合作，涉及金额不超过 6,900 万元人民币（含税价，最终交易价格以

实际签署的合同为准)，同时由公司向徐州金龙湖供应链管理有限公司提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章），单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 7 月 9 日（9:00-11:00；13:00-17:00）

（三）登记地点：北京市大兴区天荣街9号世农大厦3层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：冯四江

地 址：北京市大兴区天荣街9号世农大厦3层

电 话：010-61256850-652

传 真：010-61256850-673

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日